

Star_SM3257ENBA_N0419

Formal release SM3257ENBA F/W N0419. The F/W include three package as bellow,

1. Star_SM3257ENBA_N0419_Formal (General flash supporting)
2. Star_SM3257ENBA_N0419_Multiple CE-Die

此版 Support 以下 Flash:

1. (Support 6D2H、6DDJ 2CE 低格)
2. (Support Sandisk FT fail Sample:24nm&32nm MLC)
3. (Support Sandisk 24nm MLC 1CE4Die)
3. Star_SM3257ENBA_N0411_24nm4CE
Only support 24nm MLC 6D2G 32GB 45 DE 94 82 76 56 (4CE/4Die) (32768MB)

主要更新:

1. 提升 6D2J bin 级。修正 2 Plane Flash PXS Mode 在特定情况下弹窗的问题。
2. 提升 SA19nm MLC Toggle 开卡及 H2 良率。
3. 更新 MPTool, 支持客户 [SM3257ENBA 的低格结果以不同颜色显示] 的特殊需求。

如果客户需要, 请在 UFD_MP\Setting.ini 里设定: CostomerType=9 // F/W 默认=0

Star_SM3257ENBA_N0411

1. 新增 Support 7DDK。
2. 更新 [6D2J/6DDJ/6DDK/7DDK/4D2H/5D2H/8K (6D2H/6D2G)/16k-6D2G/16K-8T2B] 的 DLL, 修复 PXS Mode 的 bug (P.S: 6DDK/7DDK 没有开 PXS, 不过 DLL 已有更新支持! 如果需要开启只要修改 Script)
3. 提高 L74BT Bin1 比例。
4. 提高 6TCK 良率。
5. 新增 6TDK Mark bad 功能。
6. 更新 ISP, 解决 hynix 8T2B 16k 占容问题。

Star_SM3257ENBA_N0405

主要更新:

1. 提升 6D2G 16K 的 Bin 级及良率。
2. 更新 uDiskToolBar, 解决加密分区问题。
3. 提高 6T2J 开卡 Bin 级及良率。
4. 提高 K9GCGD8U0C 开卡及 H2 良率。

Star_SM3257ENBA_N0323

主要更新:

1. 提升 7T2J 开卡容量及 H2 良率。(Flash ID: 45 4C A8 92 76 57)
2. 增加 19nm/24nm 在 MpTool 显示 ECC Threshold 的功能

更新 MPTOOL.

在 Setting.set 中设置

[FUNCTION]

EnableShowECCThreshold=1

效果如下图:



3. 提升 8T2B 开卡及 H2 良率。

Star_SM3257ENBA_N0315

主要更新:

1. 提升 6T2J 开卡容量及 H2 良率。
2. 提升 6D2G 16K 开卡容量及 H2 良率。
3. 提升 4D2F 开卡容量。
4. 更新 20nm 16K 文件夹,补满 info index page。
5. 解决 Intel L84 开卡 Fail 问题。
6. 更新 MPTool
 - a) 解决防误操作 Function。
 - b) 更新 UFD_Tool 裡的檔案, 主要修改這些 Tool 支援 Win7 的 support.
7. 19nmMLC,HY_20nmMLC,HY_26nmMLC, Info index 补满 data page 修复高格 2Plane bitable 错误 bug。
8. 提升 8T2B Bin 級,H2 良率提升, 解决对比初体失败问题。
9. 支持 6DDJ,6DDK,8T2B 低格后(B+2P+NOB Mode)高格转 SM3267 (SM3267F/W 另行 Release)。

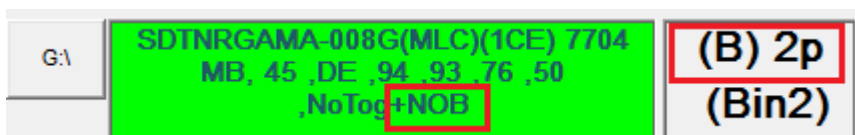
Star_SM3257ENBA_N0310

主要更新:

1. 支持 SM3257ENBA 智能 bad column 低格轉 SM3267AB x1 x2 高格 with 6DDJ and 6DDK
在 MPTool “其它设定” 里面, 勾选: Enable Smart Bad Column : 5(或者 50)(如下图):



开卡后 MPTool 上会多秀出 “NOB” Mode,如下图:



NOB 目前代表的意思是 Bad Column 砍很少所以不砍 Bad Column, 秀[2Plane 且 Block Mode +NOB]
这类 flash 可提供转换至 2703 与 3267

2. 更新对 L84,L83,SA19nm MLC,SA21nm MLC,SA27nm MLC,7T2J,6T2H,5T2F, 6TCK_A19_4Plane Infor Index 补满
3. 提高 Toshiba/Sandisk 6DDJ(98/45 DE 94 93 76 D7)ICE UDP 开卡良率
4. 提高 Toshiba 4D2F 开卡容量

5. 解决 6DDK (6DDJ)开启智能 BadColumn 设置为 5 时，部分 Sample 报 0x11 的问题
6. 更新 MPTool,Support 在 Win7 64bit 系统测试
7. Modify F/W to improve performance and test yield with Hynix 20nm MLC UCG8T2A

Star_SM3257ENBA_N0228

主要更新:

1. 新增支持 1ynm TLC 低格及双贴高格 (ID : 45,DE,A8,92,76,50)
2. 新增支持 25nm L74
3. 新增 SM3257ENBA+Samsung19nmTLC(K9ADGD8U0M) 双贴高格
4. 解决 FW-N0222-Toshiba 5T2J 高格降容问题
5. 解决 5DCJ,6DCJ,6DDJ,6DDK 估容问题
6. 提高 Sandisk 1Ynm TLC (45 DE 98 92 72 50) 测试良率
7. 提高 6DDJ,6DCJ Bin 级及良率

Star_SM3257ENBA_N0222

主要更新:

1. 提高 HY 20nm 8K 8T2A 的良率.
2. Support 8K512/7T2J 双贴低格.
3. Support Samsung 21nm MLC K9GCGD8U0A 低格开卡.
4. 修正 5T2J,6T2J 低格开卡的一个 Bug.
5. Support 19nm MLC 6D2J 低格, Auto2p 高格及双贴高格.

Star_SM3257ENBA_N0215

主要更新:

1. 更新了 HY20nm (8T2A/8T2B/8T2C)copy back mode issue
2. 更新 ForceFlash.set, 增加 6D2G 16K
3. 增加支持 4D2H 单贴 1P 低格开卡, 双贴 1P 高格开卡
4. 提高 6DDK 开卡良率
5. 增加 6D2J 单贴 1P 低格开卡支持
6. 提升 Sa 19nm TLC K9ADGD8U0M 开卡量率
7. 提高 L84 开卡良率
8. 增加支持 L83A, ID: 2C,44,44,4B,A9,00
9. 提升 6DCJ 开卡量率
10. 解 TS 19nm MLC Toggle mode 认盘 Issue

Star_SM3257ENBA_N0209

支持目前 SM3257ENBA support 的所有 Flash 混料开卡, F/W 默认设定为:Auto Set ECC.

☑黑片设定

☑黑片设定

☐ 高格

☒ 低格

优化方式: 容量优先(默认)

☒ 启动最大ECC临界值(Bits)

Auto Set ECC

如需改为手动设定 ECC，请在 **Setting.set** 中[FUNCTION]

AutoloadFlashECC=0

主要更新：

1. Fix 7T2J 4Plane 开卡 PASS 后，H2 掉盘问题
2. 支持 6D2G 16K Page 单贴 1P 低格开卡支持，双贴 1P 高格开卡
3. Improve 6DCJ 開卡良率
4. Support Micron M61A: 2C 38 00 26 85 00
5. Fix 6DDJ 8K,512page 分区时秀“格式化失败”的问题
6. 更新 MPTOOL
 - 1. Fix Show 2 Plane for Hynix 20nm 16K on SM3267AB
 - 2. Fix Multi-Lun issue for SM3267AB